



同期会议

Accompanying Meetings



国际电子电路（上海）展览会

技术交流 / 新产品技术发布会

Seminar / New Product Technology Conference

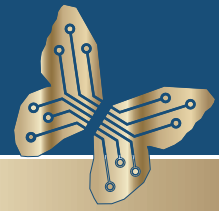
国家会展中心（上海）
National Exhibition and Convention Center (Shanghai)

3月19日 星期二 / March 19, Tuesday		7.1 Hall M704 会议室
13:00-13:45	高频覆铜板在 5G 及毫米波领域应用 颜睿翔 先生 / 技术工程师 南亚电子材料（昆山）有限公司	High frequency CCL materials for 5G and mm-wave applications Mr. Ray Yen / Engineer Nan Ya Electronic Materials(Kunshan) CORP.,LTD.
14:00-14:45	新型磷阻燃剂，适用于复合材料和覆铜板的阻燃 Mr.Sergei Levchik / R&D Director 以化集团	New Phosphorus Flame Retardants for Copper Clad Laminates and Composite Materials Mr.Sergei Levchik / R&D Director ICL-IP
15:00-15:45	应用于 mSAP 之镀铜添加剂以改善表面问题并具备优异的均匀性 颜铭瑶 先生 / 电镀 /IC 载板应用研发主管 杜邦中国集团有限公司	Acid copper for mSAP process to solve appearance issue and with superior uniformity Mr.Sean Yen / EP/IC Substrate Application Development Leader Du Pont China Holding Co., Ltd.
3月20日 星期三 / March 20, Wednesday		7.1 Hall M704 会议室
10:00-10:45	瀚森酚醛树脂为 PCB 行业提供定制化解决方案 甄洪石 先生 / 高级技术服务经理 瀚森化工企业管理（上海）有限公司	Hexion customized phenolic resin solution for PCB industry Mr.Zhen Hongshi / Technical Service Hexion Management (Shanghai) Co., Ltd.
11:00-11:45	如何最有效及具竞争力综合应用：ERP, MES, APM, TPM, WMS 和手机装置去管理工厂运营 严兆葭 先生 / 创办者 Rocket Data Technology Limited / 环球电路板设备有限公司	How to manage Plant Operation by applying ERP, MES, APM, TPM, WMS and Mobile Devices most effectively and competitively Mr.Robert Yan / Founder Rocket Data Technology Limited / World Wide PCB Equipments Co., Ltd.
13:00-13:45	NPG186 NP196 材料介绍 洪文裕 先生 / 技术处副处长 南亚电子材料（昆山）有限公司	Introduction of Nanya new material NPG186&NP196 Mr.Hong Wenyu / Director of the Tech Department Nan Ya Electronic Materials(Kunshan) CORP., LTD.
14:00-14:45	浅谈高频覆铜板、导热覆铜板材料的市场应用与产品优势以及华正材料介绍 李保忠 先生、林广文 先生 / 市场总监 浙江华正新材料股份有限公司	Discussion on Market Application and Product Advantages of High-frequency Materials & Thermal Conductive Materials and Introduction of Wazam Materials. Mr.Bob Li、Mr.Simon lin / Marketing Director Zhejiang Wazam New Material Co., Ltd.
15:00-15:45	新形势与政策下 PCB 工业园污水处理厂运营管理重难点分析 刘诗燕 先生 / 营销技术总监 广东新大禹环境科技股份有限公司	Analysis of Difficulties in operation management of PCB industrial park wastewater treatment plant under new situation and policy Mr.Liu Shiyang / Marketing technical director GUANGDONG XINDAYU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO.,LTD.



同期会议

Accompanying Meetings



国际电子电路（上海）展览会

2019 春季国际 PCB 技术 / 信息论坛
International PCB Technology and Information Spring Forum 2019

国家会展中心（上海）/ 上海虹桥假日酒店
National Exhibition and Convention Center (Shanghai) /
Holiday Inn Shanghai Hongqiao

3月19日 星期二 March 19, Tuesday

展馆办公楼 C 座 3 楼 C0-02 会议室 / 论坛开幕式

13:00-13:15	论坛开幕式·领导致辞
13:15-14:00	《PCB 这十年——产业回顾与展望》 由镭 理事长·中国电子电路行业协会
14:00-14:30	《改革开放四十年中国半导体行业的发展和未来》 任振川 信息部主任·中国半导体行业协会
14:30-15:00	《鹏鼎电子创业创新之路》 沈庆芳 董事长兼 CEO·鹏鼎控股（深圳）股份有限公司
15:00-15:20	《5G: 于印制电路板生产上的影响及安美特可应对的解决方案》 简建生 资深专家·安美特（中国）化学有限公司
15:20-16:00	《PCB 市场转型时的不确定性和机遇》 姜旭高 博士·PRISMARK
16:00-16:30	《未来半导体芯片封装技术》 Rob Fastenau 教授 / 副校长·荷兰代尔夫特理工大学 TU Delft
16:30-17:30	主题对话：引领智造新时代 对话嘉宾：深南电路股份有限公司·杨之诚 董事长 Dr. Wolfgang Babel CEO·Helmut Fischer Group 武守坤 董事长·深圳市金百泽电子科技股份有限公司 杨朝辉 总经理·深圳市大族数控科技有限公司 董晓军 副总经理·广东生益科技股份有限公司 罗春峰 总经理·深圳市金洲精工科技股份有限公司

3月20日 星期三 / March 20, Wednesday

时间 / 场次	上海虹桥西郊假日酒店 3F 竞衡厅	时间 / 场次	上海虹桥西郊假日酒店 3F 竞衡厅
08:30-08:50	飞尾结构的刚挠结合板研制与生产 穆敦发·上海嘉捷通电路科技股份有限公司	13:00-13:20	安美特能满足新 IPC 标准的新化学镍金工艺 李家康 产品市场经理·安美特（中国）化学有限公司
08:50-09:10	一种挠性 PCB 化学镀铜液 李晓红·广东天承科技有限公司	13:20-13:40	化学沉锡板锡须生长机理及特性研究 周波·广州兴森快捷电路科技有限公司
09:10-09:30	多层柔性线路板孔口孔薄影响因素研究 陈春锦·深圳市景旺电子股份有限公司	13:40-14:00	不同压合工艺的对准度研究分析 傅宝林·生益电子股份有限公司



同期会议

Accompanying Meetings



国际电子电路（上海）展览会

3月20日 星期三 / March 20, Wednesday

时间 / 场次	上海虹桥西郊假日酒店 3F 竞衡厅	时间 / 场次	上海虹桥西郊假日酒店 3F 竞衡厅
09:30-09:50	高频高导热覆铜板的研制 颜善银·广东生益科技股份有限公司	14:00-14:20	服务器板成品涨缩控制 钟根带·广合科技（广州）有限公司
09:50-10:10	精细线路阻抗制作研究 金立奎·珠海方正科技高密电子有限公司	14:20-14:40	化锡可焊性研究 马国强·深南电路股份有限公司
10:10-10:30	无损铜面粘接技术原理及在高频印制板制造中的优势 何康·深圳市贝加电子材料有限公司	14:40-15:00	化学镀镍废液采用 ECRM 电催化技术处理运行效果分析 王怡璇·深圳市世清环保科技有限公司
10:30-10:50	大数据在 PCB 工艺管理 / 控制的应用 林旭荣·汕头超声印制板公司	15:00-15:20	浅谈 5G 通讯天线印制板 PIM 信号 PCB 加工过程的主要影响 房鹏博·珠海杰赛科技有限公司
10:50-11:10	铜面前处理制程对激光直接钻孔的影响因素探讨 叶绍明·广东东硕科技有限公司	15:20-15:40	基于高清音视频信号实时采集处理关键控制器件的超大尺寸背板 关键技术研究 张长明·深圳市博敏电子有限公司
11:10-11:30	PCB 二线与四线电性能测量技术研究 聂兴培·惠州市金百泽电路科技有限公司	15:40-16:00	信号完整性案例分析探讨 秦清·生益电子股份有限公司
11:30-11:50	远红外磁共振技术实现金属镀层结晶超微化 刘东·江门市奔力达电路有限公司	16:00-16:20	毫米波雷达印制板微带天线的技术研究 袁欢欣·汕头超声印制板公司
11:50-12:10	电镀金镀层厚度均匀性提升研究 孟凡义·汕头超声印制板公司	16:20-16:40	高速高多层电路板的关键技术研究 袁为群·深圳崇达多层线路板有限公司
12:10-12:15	揭晓上午场演讲论文评分结果	16:40-17:00	乙基香兰素对甲基磺酸盐体系电镀锡的影响研究 胡甲聪·电子科技大学
12:15-13:00	午餐 (凭餐券)	17:00-17:20	沉铜后停放时间对盲孔底部结合力影响的研究 白亚旭·江门崇达电路技术有限公司
		17:20-17:40	沉锡工艺离子污染洁净度失效的原因分析与改善 刘帅·天津普林电路股份有限公司
		17:40-17:45	揭晓下午场演讲论文评分结果